

烟台德邦科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 证券简称：德邦科技     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 证券代码：688035 | 编号：2026-004 |
| 投资者关系活动类别     | <div><div>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div><div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/> 路演活动</div></div> <div><div>现场参观</div><div><input type="checkbox"/> 其他</div></div> |             |             |
| 参与单位名称及人员姓名   | 国投证券、清溪投资、南方基金、鹏华基金、趣时资产、国海证券、中金证券、千禧投资、松熙投资、申万菱信基金、宝盈基金、西部证券、长江证券、中庚基金、摩根基金、广发基金、平安基金、中邮证券等                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |
| 时间            | 2026 年 7 月 1 日-7 月 16 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |
| 地点            | 公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |
| 上市公司接待人员姓名    | <div>董事长：解海华</div> <div>董事会秘书：于杰</div> <div>董事会办公室总监：战世能</div> <div>证券事务代表：翟丞</div>                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>1、请介绍一下公司各业务板块占比情况及近期增长趋势？</div> <div>答：公司以集成电路封装材料技术为引领，聚焦集成电路封装、智能终端封装、新能源应用、高端装备应用四大应用领域。根据 2025 年度数据，公司各业务板块均呈现增长态势：集成电路板块呈现持续快速增长的趋势，板块业务占比明显提升；智能终端板块在新应用场景、新应用点持续突破和放量，板块增速也明显好于公司整体增速；新能源板块始终保持稳定的市场份额，随着行业趋势持续稳定增长。</div>                                                                                          |             |             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>2、请介绍一下公司集成电路业务具体产品情况？</b></p> <p>答：集成电路封装材料主要包括导热系列（导热垫片、凝胶、相变化材料 PCM、液态金属）、固晶系列（DAP、DAF/CDAF 膜）、芯片封装薄膜系列（UV 减薄膜、UV 切割膜）、底部填充材料、Lid 框胶（AD 胶）及临时键合胶等，主要客户包括国内主流芯片设计公司、封测企业以及组装厂等。</p> <p><b>3、请介绍一下公司 Tim 材料下游主要应用领域和场景？</b></p> <p>答：公司 TIM 材料主要应用于消费电子、汽车电子、存储、服务器、通讯及新能源等领域。公司 TIM 材料从应用位置区分包括 Tim1、Tim1.5 及 Tim2 产品，其中 Tim1.5 及 Tim2 已批量出货，Tim1 已通过国内某重要封测厂全套验证。</p> <p><b>4、请问公司哪些产品能够匹配先进封装工艺，请具体介绍一下相关产品和应用工艺？以及竞争格局情况？</b></p> <p>答：公司专注于高端电子封装材料研发及产业化，致力于为集成电路封装提供晶圆固定、切割、减薄、键合、导电、导热、保护及提高芯片使用可靠性的综合性产品解决方案。目前公司多款核心产品可直接适配各类先进封装工艺，主要包括：UV 膜（UV 减薄膜、UV 切割膜）、临时键合胶、固晶膜（DAF/CDAF）、芯片级底部填充胶、Lid 框胶、Tim1 等产品。</p> <p>从行业竞争格局来看，国内高端先进封装材料领域长期由海外头部厂商主导，整体国产化率较低，行业国产替代空间广阔、市场潜力巨大。公司将紧抓半导体材料国产化的行业发展机遇，持续深耕先进封装材料赛道，不断迭代优化产品性能、提升产业化能力，全力推动高端封装材料的国产替代进程。</p> <p>现阶段，公司上述产品目前尚处于小批量交付阶段。</p> <p><b>5、请介绍一下公司应用于存储领域的产品情况？</b></p> <p>答：目前公司固晶系列、导热系列等产品均已批量应用于存储领域。其中固晶胶产品目前已批量稳定供货，DAF（固晶膜）</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>产品实现小批量出货；公司高导热界面材料已批量应用于存储领域，且配套国外客户。</p> <p><b>6、请介绍公司智能终端业务的整体情况？</b></p> <p>答：公司在多产品、多项目中积极布局，产品核心竞争力持续增强，智能终端市场份额稳步提升，相关材料可广泛应用于手机、耳机、智能手表、平板电脑、笔记本电脑、车载电子、平板显示等各类智能终端。其中，TWS 耳机依托密封与粘接技术优势，顺利进入海内外头部客户供应链；智能手机 LIP0 超窄边框封装技术加速落地；车载电子多品类批量导入，偏光片业务亦进入快速增长期。</p> <p><b>7、请介绍一下公司新能源业务情况？</b></p> <p>答：公司新能源业务主要涉及锂电和光伏两部分，其中锂电主要涉及材料为应用于动力电池和储能电池电池包内部的结构导热材料，目前该业务公司处于行业领先地位，产品主要供给宁德时代、比亚迪、国轩、亿纬等国内头部电池厂商，光伏业务主要产品为叠瓦导电胶、基于 00B 技术的 UV 胶以及少量其他光伏封装材料，产品供应国内外客户。随着下游新能源汽车产销稳步增长、储能行业加速普及渗透，公司新能源应用材料出货量保持稳健增长。</p> |
| 附件清单<br>(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |